

中国半导体硅片行业现状深度研究与投资前景预测报告（2024-2031）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国半导体硅片行业现状深度研究与投资前景预测报告（2024-2031）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202402/693537.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

半导体硅片是一种以硅（Si）为基础材料制作的半导体器件基板，是半导体产业最重要的基础材料，也是集成电路和各种半导体器件的载体，应用前景广阔。根据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2022年我国半导体硅片出货量约为19.74亿平方英寸，销售额达到138亿元。

当前，我国半导体硅片行业集中度较为分散，2022年CR6不足45%，主要有TCL中环（002129）、众合科技（000925）、有研硅（688432）、立昂微（605358）、扬杰科技（300373）等上市企业。其中，沪硅产业（68812）2022年市场份额排名第一，是我国半导体硅片行业头部企业，市场份额排名前三的企业还有有研硅（688432）和众合科技（000925）。

我国半导体硅片行业相关企业情况

公司简称	成立时间	竞争优势
TCL中环（002129）	1988年12月	公司拥有先进的半导体技术背景，在大尺寸硅片制造上积累了丰富的经验和高水平的制造技术，确保了其在成本和质量上的领先；采用工业4.0的生产理念，通过设备和系统的自动化深度开发，实现了从原料到成品的全过程自动化，提高了生产效率和产品质量。

众合科技（000925）1999年6月 公司在智能交通、智慧城市和半导体领域拥有世界领先的技术实力，并不断投入研发，保持技术的持续领先。同时，公司还与多个高校和研究机构合作，确保技术创新的持续性和前瞻性。有研硅（688432）2001年6月 公司是中国最早从事半导体直拉硅单晶研制的企业之一，在国内率先实现了6英寸、8英寸硅片的研制及产业化，产品已涵盖6-8英寸半导体硅单晶及抛光片、11-19英寸刻蚀

设备用硅材料、4-8英寸半导体区熔硅单晶及抛光片等。立昂微（605358）2002年3月 公司拥有完全自主知识产权优势；拥有完整的产业链优势，从拉单晶开始到抛光片再到外延片，产品毛利率较高；经过公司二十余年的客户开拓与认证，公司积累了国内外众多知名客户，已占据了非常有利的供应商地位。扬杰科技（300373）2006年8月 公司拥有一支专业的研发团队，始终保持对新技术、新材料、新工艺的探索与研究；采用严格的质量管理体系和先进的生产工艺技术，确保产品的性能和质量达到国际一流水平。

中晶科技（003026）2010年1月 公司在半导体材料、器件和应用等方面拥有多项核心专利和技术，具备技术领先优势；具备完整的半导体产业链，从材料到器件再到应用，各个环节都能够自主生产和研发。沪硅产业（68812）2015年12月 公司半导体硅片业务产能布局、业务资质、专利授权、业务营收方面占有优势，是国产半导体硅片龙头厂商，领航硅片行业国产替代；突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术，打破了我国 12英寸半导体硅片国产化率几乎为0%的局面。

资料来源：公开资料、观研天下整理

从企业业绩来看，2023年前三季度TCL中环（002129）实现营业收入和归母净利润同比双增长，营业收入为486.5亿元，同比增长23.75%，归母净利润为61.88亿元，同比增长6.51%。众合科技（000925）、有研硅（688432）、立昂微（605358）、扬杰科技（300373

) 四家公司营业收入和归母净利润同比双下降。其中，众合科技(000925)营业收入和归母净利润下降最多，数据显示，其2023年前三季度实现营业收入13.51亿元，同比下降17.16%；归母净利润为-2744万元，同比下降161.88%。

2023年前三季度我国半导体硅片行业部分上市公司营收情况

公司简称	营业收入	同比增长	归母净利润	同比增长
TCL中环(002129)	486.5亿元	23.75%	61.88亿元	6.51%
众合科技(000925)	13.51亿元	-17.16%	-2744万元	-161.88%
有研硅(688432)	7.903亿元	-14.53%	2.222亿元	-22.85%
立昂微(605358)	20.13亿元	-11.66%	1.854亿元	-71.10%
扬杰科技(300373)	40.41亿元	-8.54%	6.179亿元	-33.39%
中晶科技(003026)	2.560亿元	0.12%	-1986万元	-181.52%
沪硅产业(68812)	23.90亿元	-7.94%	2.125亿元	68.76%

数据来源：各公司财报、东方财富网、观研天下整理

从企业动态来看，2023年1月，TCL中环新能源科技股份有限公司发布公告称，为加强半导体硅片制造领域的竞争优势，公司控股子公司中环领先半导体材料有限公司以新增注册资本方式收购江苏鑫华半导体科技股份有限公司100%股权，交易对价为人民币77.57亿元；2023年4月，半导体硅片独角兽西安奕斯伟材料科技股份有限公司同中信证券签署上市辅导协议，正式启动A股IPO进程；2023年6月，江苏东煦电子科技有限公司投资3亿元的江苏东煦电子项目开工奠基，该项目建成投产后，可形成年产400万件电子级胶带、30万片半导体用硅片、100台AOI视检设备的生产能力，预计实现年产值10亿元。

2023年6月，江苏鑫华半导体科技股份有限公司完成10亿元B轮融资；2023年12月，上海硅产业集团股份有限公司发布公告称，子公司上海新昇半导体科技有限公司拟91亿元投建半导体硅片材料生产基地项目，加快300mm半导体硅片产能建设；2024年1月，该公司发布业绩预告，预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.68亿元到2.01亿元，同比下降38.16%到48.31%；2024年2月，上海合晶硅材料股份有限公司在上海证券交易所科创板上市，公司总市值达到约140.56亿元。

2023年-2024年2月我国半导体硅片行业企业动态	公司名称	时间	事件
TCL中环新能源科技股份有限公司	TCL中环新能源科技股份有限公司	2023年1月	TCL中环新能源科技股份有限公司发布公告称，为加速提升公司半导体业务市场占有率，通过扩大产能规模、产品结构升级、提升技术研发能力，加强半导体硅片制造领域的竞争优势，公司控股子公司中环领先半导体材料有限公司以新增注册资本方式收购江苏鑫华半导体科技股份有限公司100%股权，交易对价为人民币77.57亿元。
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	西安奕斯伟材料科技股份有限公司	2023年4月	半导体硅片独角兽西安奕斯伟材料科技股份有限公司同中信证券签署上市辅导协议，正式启动A股IPO进程。
江苏东煦电子科技有限公司	江苏东煦电子科技有限公司	2023年6月	江苏东煦电子科技有限公司投资3亿元的江苏东煦电子项目开工奠基，该项目建成投产后，可形成年产400万件电子级胶带、30万片半导体用硅片、100台AOI视检设备的生产能力，预计实现年产值10亿元。
江苏鑫华半导体科技股份有限公司	江苏鑫华半导体科技股份有限公司	2023年6月	江苏鑫华半导体科技股份有限公司完成10亿

元B轮融资，投资方包括中建材新材料基金、中车转型基金、建信投资、浦东科创、成都科创、元禾厚望、御海资本、泓生资本等知名机构。上海硅产业集团股份有限公司2023年12月国内半导体硅片头部企业上海硅产业集团股份有限公司发布公告称，子公司上海新昇半导体科技有限公司拟91亿元投建半导体硅片材料生产基地项目，加快300mm半导体硅片产能建设。上海硅产业集团股份有限公司2024年1月上海硅产业集团股份有限公司发布业绩预告，预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.68亿元到2.01亿元，同比下降38.16%到48.31%。上海合晶硅材料股份有限公司2024年2月上海合晶硅材料股份有限公司在上海证券交易所科创板上市，公司总市值达到约140.56亿元。据悉，上海合晶成立于1994年，主要从事半导体硅外延片一体化制造，主要产品为半导体硅外延片。

资料来源：公开资料、观研天下整理（WJ）

注：上述信息仅供参考，具体内容请以报告正文为准。

观研报告网发布的《中国半导体硅片行业现状深度研究与投资前景预测报告（2024-2031）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国半导体硅片行业发展概述

第一节 半导体硅片行业发展情况概述

一、半导体硅片行业相关定义

二、半导体硅片特点分析

三、半导体硅片行业基本情况介绍

四、半导体硅片行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、半导体硅片行业需求主体分析

第二节中国半导体硅片行业生命周期分析

一、半导体硅片行业生命周期理论概述

二、半导体硅片行业所属的生命周期分析

第三节半导体硅片行业经济指标分析

一、半导体硅片行业的赢利性分析

二、半导体硅片行业的经济周期分析

三、半导体硅片行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球半导体硅片行业市场发展现状分析

第一节全球半导体硅片行业发展历程回顾

第二节全球半导体硅片行业市场规模与区域分布情况

第三节亚洲半导体硅片行业地区市场分析

一、亚洲半导体硅片行业市场现状分析

二、亚洲半导体硅片行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲半导体硅片行业市场前景分析

第四节北美半导体硅片行业地区市场分析

一、北美半导体硅片行业市场现状分析

二、北美半导体硅片行业市场规模与市场需求分析

三、北美半导体硅片行业市场前景分析

第五节欧洲半导体硅片行业地区市场分析

一、欧洲半导体硅片行业市场现状分析

二、欧洲半导体硅片行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲半导体硅片行业市场前景分析

第六节 2024-2031年世界半导体硅片行业分布走势预测

第七节 2024-2031年全球半导体硅片行业市场规模预测

第三章 中国半导体硅片行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

第二节我国宏观经济环境对半导体硅片行业的影响分析

第三节中国半导体硅片行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节政策环境对半导体硅片行业的影响分析

第五节中国半导体硅片行业产业社会环境分析

第四章 中国半导体硅片行业运行情况

第一节中国半导体硅片行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节中国半导体硅片行业市场规模分析

一、影响中国半导体硅片行业市场规模的因素

二、中国半导体硅片行业市场规模

三、中国半导体硅片行业市场规模解析

第三节中国半导体硅片行业供应情况分析

一、中国半导体硅片行业供应规模

二、中国半导体硅片行业供应特点

第四节中国半导体硅片行业需求情况分析

一、中国半导体硅片行业需求规模

二、中国半导体硅片行业需求特点

第五节中国半导体硅片行业供需平衡分析

第五章 中国半导体硅片行业产业链和细分市场分析

第一节中国半导体硅片行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、半导体硅片行业产业链图解

第二节中国半导体硅片行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对半导体硅片行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对半导体硅片行业的影响分析

第三节我国半导体硅片行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国半导体硅片行业市场竞争分析

第一节 中国半导体硅片行业竞争现状分析

一、中国半导体硅片行业竞争格局分析

二、中国半导体硅片行业主要品牌分析

第二节 中国半导体硅片行业集中度分析

一、中国半导体硅片行业市场集中度影响因素分析

二、中国半导体硅片行业市场集中度分析

第三节 中国半导体硅片行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国半导体硅片行业模型分析

第一节 中国半导体硅片行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节 中国半导体硅片行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国半导体硅片行业SWOT分析结论

第三节 中国半导体硅片行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国半导体硅片行业需求特点与动态分析

第一节中国半导体硅片行业市场动态情况

第二节中国半导体硅片行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节半导体硅片行业成本结构分析

第四节半导体硅片行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节中国半导体硅片行业价格现状分析

第六节中国半导体硅片行业平均价格走势预测

一、中国半导体硅片行业平均价格趋势分析

二、中国半导体硅片行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国半导体硅片行业所属行业运行数据监测

第一节中国半导体硅片行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节中国半导体硅片行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节中国半导体硅片行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国半导体硅片行业区域市场现状分析

第一节中国半导体硅片行业区域市场规模分析

一、影响半导体硅片行业区域市场分布的因素

二、中国半导体硅片行业区域市场分布

第二节中国华东地区半导体硅片行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区半导体硅片行业市场分析

(1) 华东地区半导体硅片行业市场规模

(2) 华南地区半导体硅片行业市场现状

(3) 华东地区半导体硅片行业市场规模预测

第三节华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区半导体硅片行业市场分析

(1) 华中地区半导体硅片行业市场规模

(2) 华中地区半导体硅片行业市场现状

(3) 华中地区半导体硅片行业市场规模预测

第四节华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区半导体硅片行业市场分析

(1) 华南地区半导体硅片行业市场规模

(2) 华南地区半导体硅片行业市场现状

(3) 华南地区半导体硅片行业市场规模预测

第五节华北地区半导体硅片行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区半导体硅片行业市场分析

(1) 华北地区半导体硅片行业市场规模

(2) 华北地区半导体硅片行业市场现状

(3) 华北地区半导体硅片行业市场规模预测

第六节东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区半导体硅片行业市场分析

- (1) 东北地区半导体硅片行业市场规模
- (2) 东北地区半导体硅片行业市场现状
- (3) 东北地区半导体硅片行业市场规模预测

第七节西南地区市场分析

- 一、西南地区概述
- 二、西南地区经济环境分析
- 三、西南地区半导体硅片行业市场分析
 - (1) 西南地区半导体硅片行业市场规模
 - (2) 西南地区半导体硅片行业市场现状
 - (3) 西南地区半导体硅片行业市场规模预测

第八节西北地区市场分析

- 一、西北地区概述
- 二、西北地区经济环境分析
- 三、西北地区半导体硅片行业市场分析
 - (1) 西北地区半导体硅片行业市场规模
 - (2) 西北地区半导体硅片行业市场现状
 - (3) 西北地区半导体硅片行业市场规模预测

第十一章 半导体硅片行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
 - 1、主要经济指标情况
 - 2、企业盈利能力分析
 - 3、企业偿债能力分析
 - 4、企业运营能力分析
 - 5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第三节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第七节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第八节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第十二章 2024-2031年中国半导体硅片行业发展前景分析与预测

第一节 中国半导体硅片行业未来发展前景分析

- 一、半导体硅片行业国内投资环境分析
- 二、中国半导体硅片行业市场机会分析
- 三、中国半导体硅片行业投资增速预测

第二节 中国半导体硅片行业未来发展趋势预测

第三节 中国半导体硅片行业规模发展预测

- 一、中国半导体硅片行业市场规模预测
- 二、中国半导体硅片行业市场规模增速预测
- 三、中国半导体硅片行业产值规模预测
- 四、中国半导体硅片行业产值增速预测
- 五、中国半导体硅片行业供需情况预测

第四节 中国半导体硅片行业盈利走势预测

第十三章 2024-2031年中国半导体硅片行业进入壁垒与投资风险分析

第一节 中国半导体硅片行业进入壁垒分析

- 一、半导体硅片行业资金壁垒分析
- 二、半导体硅片行业技术壁垒分析
- 三、半导体硅片行业人才壁垒分析
- 四、半导体硅片行业品牌壁垒分析
- 五、半导体硅片行业其他壁垒分析

第二节 半导体硅片行业风险分析

- 一、半导体硅片行业宏观环境风险
- 二、半导体硅片行业技术风险
- 三、半导体硅片行业竞争风险
- 四、半导体硅片行业其他风险

第三节 中国半导体硅片行业存在的问题

第四节 中国半导体硅片行业解决问题的策略分析

第十四章 2024-2031年中国半导体硅片行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国半导体硅片行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国半导体硅片行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节半导体硅片行业营销策略分析

一、半导体硅片行业产品策略

二、半导体硅片行业定价策略

三、半导体硅片行业渠道策略

四、半导体硅片行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202402/693537.html>